公司代码:600460　　公司简称:士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	士兰微	600460	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈越	马良
电话	0571-88210880	0571-88212880
办公地址	浙江省杭州市黄姑山路4号	浙江省杭州市黄姑山路4号
电子信箱	600460@silan.com.cn	ml@silan.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,452,543,863.32	8,126,368,334.95	4.01
归属于上市公司股东的净资产	3,485,743,827.20	3,427,867,217.69	1.69
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-55,774,773.75	-10,553,926.22	不适用
营业收入	1,440,309,565.89	1,437,089,382.68	0.22
归属于上市公司股东的净利润	57,812,582.87	95,312,560.35	-39.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,844,899.10	67,101,029.74	-116.16
加权平均净资产收益率(%)	1.67	2.92	减少1.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.044	0.073	-39.73
稀释每股收益(元/股)	0.044	0.073	-39.73

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	150,765
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
杭州士兰控股有限公司	境内非国有法人	39.14	513,503,234	0	质押	135,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.37	31,071,900	0	无	0
厦门半导体投资集团有限公司	国有法人	1.62	21,276,595	0	无	0
陈向东	境内自然人	0.94	12,349,896	0	无	0
范伟宏	境内自然人	0.81	10,613,866	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72	9,395,378	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	0.69	9,033,943	0	无	0
邓少波	境内自然人	0.64	8,374,553	0	无	0
江忠永	境内自然人	0.63	8,250,000	0	无	0
武跳聪	境内自然人	0.60	7,862,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,在册持有本公司股份前十名无限售条件股东中的陈向东、范伟宏、邓少波、江忠永等四人为本公司第一大股东杭州士兰控股有限公司之股东。其他前十大持有无限售条件的股东之间未知是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,尽管面对中美贸易摩擦加剧,全球经济增速放缓的压力,但公司总体营业收入略有增长。2019年上半年,公司积极应对外部环境的变化,继续保持高强度的研发投入,在特色工艺平台建设、新产品开发、战略级大客户合作等方面持续取得突破,产品结构调整的步伐明显加快。

2019年上半年,公司营业总收入为144,031万元,较2018年同期增长0.22%;公司营业利润为-699万元,比2018年同期减少-111.35%;公司利润总额为-718万元,比2018年同期减少111.59%;公司归属于母公司股东的净利润为5,781万元,比2018年同期减少39.34%。2019年上半年公司经营利润下降的原因主要来自三个方面:(1)公司子公司士兰集昕6英寸芯片生产线仍处于特色工艺平台建设阶段,2018年下半年以来加大了在高端功率器件的研发投入,加之公司积极调整产品结构减少了低附加值产品的产出,导致亏损数额较去年同期加大;(2)公司子公司士兰集成受部分客户订单数量减少的影响,产能利用率下降,加之硅片等原材料成本处于历史高位,导致经营利润较去年同期下降较多;(3)公司子公司士兰明芯受LED行业波动的影响,发光二极管芯片价格较去年同期下降较多,导致亏损进一步增加。

2019年上半年,公司集成电路的营业收入为4.91亿元,较去年同期增长1.7%,公司集成电路营业收入增加的主要原因是:公司各类电路新产品的出货量明显加快。预计下半年公司集成电路的营业收入增速还将进一步提高。

2019年上半年,公司IPM功率模块产品在国内白色家电(主要是空、冰、洗)、工业变频器等市场继续发力。2019年上半年,国内多家主流的白电整机厂商在变频空调等白电整机上使用了超过300万颗士兰IPM模块,预期今后几年将会继续快速成长。

2019年上半年,基于公司自主研发的芯片、算法以及系统,公司的空调变频电控系统在国内空调厂家完成了几千台变频空调的上量试产,性能优异、质量稳定。目前公司电控类MCU产品在工业变频器、工业UPS、光伏逆变、纺织机械类伺服产品、各类变频风扇类应用以及电动自行车等众多领域都得到了广泛的应用。

2019年上半年,全部芯片自主研发的电动汽车主电机驱动模块完成研发,参数性能指标先进,已交付客户测试。

2019年上半年,公司语音识别芯片和应用方案已在国内主流的白电厂家的智能家电系统中得到较为广泛的应用。

2019年上半年,公司MEMS传感器产品营业收入较去年同期增加120%以上,国内手机品牌厂商已在认证公司MEMS传感器产品。加速度传感器、硅麦克风等产品的参数优化工作取得突破性进展;预计下半年公司MEMS传感器产品的出货量将进一步增长。

2019年上半年,公司开发的针对智能手机的快充芯片组,以及针对旅充、移动电源和车充的多协议快充解决方案的系列产品,已开始在国内手机品牌厂商进行产品导入。

2019年上半年,随着新产品上量,公司LED照明驱动电路的出货量已恢复增长。

2019年上半年,公司分立器件产品的营业收入为6.79亿元,较去年同期增长3.36%。分立器件产品营业收入增速下降的主要原因是:受外部经济增速放缓的影响,有部分客户分立器件芯片的订单数量减少。上半年,公司分立器件成品的出货量继续保持较高增长,其中低压MOSFET、超结MOSFET、IGBT、IGBT大功率模块(PIM)、肖特基管等产品的销售收入较去年同期有较大增长。预计下半年公司分立器件成品的销售将继续保持较快增长。

2019年上半年,公司子公司士兰集成总计产出芯片106.54万片,比去年同期减少7.41%;部分客户订单数量减少导致产能利用率下降,加之硅片等原材料成本处于历史高位,导致士兰集成经营利润较去年同期下降较多。下半年,士兰集成将加强成本控制,确保生产线稳定运行。

2019年上半年,士兰集成已开始进行针对"汽车级功率模块产品"的小批量产能扩充,为下一阶段汽车级功率模块厂商的设计入局和产品储备。

2019年上半年,公司子公司士兰集昕公司总计产出芯片17.6万片,比去年同期增加74.25%。上半年,士兰集昕加快了特色工艺平台建设进度。0.25微米的BCD电路工艺平台和0.18微米的BCD电路工艺平台已相继建成,并开始实现小批量产出。上半年,士兰集昕已有高压集成电路、高压超结MOS管、高密度低压沟槽栅MOS管、TRENCH肖特基管、大功率IGBT等多个产品导入量产,产品结构调整步伐明显加快。2019年下半年,士兰集昕将进一步加大对生产线投入,提高芯片产出能力。

2019年上半年,公司推出了应用于家用电磁炉的1350V RC-IGBT系列产品,该系列产品是基于士兰微电子独立自主开发的第三代场截止(Field-Stop III)工艺平台,实现在场截止型IGBT器件内部集成了续流二极管结构。现在,士兰微电子在自有的8英寸芯片生产线上已经全部实现了几类关键工艺的研发与批量生产。

2019年上半年,公司子公司成都士兰公司外延芯片车间继续保持稳定生产,模块车间功率模块、MEMS传感器的产出实现较快增长。下半年,公司将进一步提升模块车间的封装能力。

2019年上半年,公司发光二极管产品的营业收入为2.08亿元,较去年同期减少20.83%。发光二极管产品营业收入减少的主要原因是:受LED下游市场需求波动的影响,子公司士兰明芯发光二极管芯片的价格较去年同期有较大幅度的下降。对此,士兰明芯在稳固彩屏芯片市场份额的同时,加快了高亮度白光芯片的开发,加快进入中高端LED照明芯片市场,预计其下半年营业收入将逐步回升。

2019年上半年,美卡乐公司通过持续优化工艺,稳定产品质量,降低生产成本,提升产品竞争力,实现营业收入约5.5%的成长;在高端彩屏市场,"美卡乐"品牌形象得以进一步提升。

2019年上半年,厦门士兰明镓公司已完成生产厂房净化装修和动力设备安装,现正在工艺设备安装和调试,预计2019年四季度将进行试生产。

2019年上半年,厦门士兰集科公司已完成建筑工程招投标工作,厂房建设现已正式开工。下半年将积极推进厂房建设,争取在2020年3月份进入工艺设备安装阶段。

2019年上半年,公司研发的600V以上用于变频驱动的多芯片高压IGBT智能功率模块荣获集成电路产业技术创新战略联盟"第二届集成电路产业技术创新奖"。

经过20多年的发展,公司已成为目前国内较大的以"设计制造一体"(IDM)模式为主要经营模式的综合性半导体产品公司。作为IDM公司,公司带有资产相对偏重的特征,在外部经济周期变化的压力下,也会在一定程度上承受经营利润波动的压力。但是相对于轻资产型的Fabless设计公司,公司在特色工艺和产品的研发上具有更突出的竞争优势:实现了特色工艺技术与产品研发的紧密互动,以及半导体器件、集成电路和模块产品的协同发展;公司依托IDM模式形成的设计与工艺相结合的综合实力,提升产品品质、加强控制成本,向客户提供差异化的产品与服务,提高了其向大型厂商配套体系渗透的能力。随着8吋芯片生产线项目投产,以及化合物半导体器件生产线项目和12吋芯片特色工艺芯片生产线项目建设加快推进,将持续推动士兰微电子整体营收的较快成长。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(以下统称为"新金融工具准则")的规定,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。具体内容详见本财务报告附注之"重要会计政策变更"。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:陈向东

杭州士兰微电子股份有限公司

2019年8月28日

证券代码:600460　证券简称:士兰微　编号:临2019-034

杭州士兰微电子股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议于2019年8月26日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2019年8月16日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并电话确认。会议应到董事12人,实到12人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

1、《2019年半年度报告》及摘要

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:以12票同意,0票反对,0票弃权,获得一致通过。

2、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),　公告编号:临 2019-036。

表决结果:以12票同意,0票反对,0票弃权,获得一致通过。

3、《关于投资建设士兰集昕二期项目的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),　公告编号:临 2019-037。

表决结果:以12票同意,0票反对,0票弃权,获得一致通过。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2019年8月28日

证券代码:600460　证券简称:士兰微　编号:临2019-035

杭州士兰微电子股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二次会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式发出,并以电话确认。会议于2019年8月26日在公司三楼会议室召开。全体3名监事出席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由宋卫权先生主持,经与会监事认真审议,以现场表决的方式通过了以下议案:

一、会议审议通过了《2019年半年度报告》及摘要并出具了审核意见

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

审核意见:公司监事会对公司2019年半年度报告进行审核后认为公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况;参与半年报编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。

二、会议审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),　公告编号:临 2019-036。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

监事会

2019年8月28日

证券代码:600460　证券简称:士兰微　编号:临2019-036

杭州士兰微电子股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●募集资金存放是否符合公司规定:是

●募集资金使用是否符合承诺进度:不适用

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可字(2017)2005号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票不超过130,505,709股。根据询价情况,本公司与主承销商东方花旗证券有限公司最终确定向6名特定对象非公开发行普通股(A股)64,893,614股,每股面值1元,每股发行价格为人民币11.28元,共募集资金总额为731,999,965.92元。扣除承销费、保荐费25,440,000.00元(其中进项税额1,440,000.00元)后的募集资金为706,559,965.92元,已由主承销商东方花旗证券有限公司于2018年1月3日汇入本公司在农业银行股份有限公司杭州下沙支行开立的账号为19033101040020262人民币账户内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用2,405,660.37元后,本公司本次募集资金净额705,594,305.55元。上述募集资金业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2018)1号)。

(二) 募集资金投资项目情况及实施方式

1. 本公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	投资金额		核准部门及文号
	总投资额	募集资金投资额	
年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目	80,253.00	80,000.00	
其中:MEMS传感器芯片制造扩产项目	37,900.00	37,647.00	杭州经济技术开发区经济发展局杭经开经技备案(2017)15号、6号
MEMS传感器封装项目	22,362.00	22,362.00	金堂县经济科技和信息化局 金经信技改备案(2017)1号
MEMS传感器测试能力提升项目	19,991.00	19,991.00	杭州市滨江区发展改革和经济局滨发改体改(2017)003号
合 计	80,253.00	80,000.00	

实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额,本公司将按照项目的轻重缓急,将募集资金用于MEMS传感器芯片制造扩产项目、MEMS传感器封装项目和MEMS传感器测试能力提升项目,不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。其中,MEMS传感器芯片制造扩产项目实施主体为本公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(以下简称士兰集成公司),MEMS传感器封装项目实施主体为本公司全资子公司成都士兰半导体制造有限公司(以下简称成都士兰公司),实施方式为募集资金到位后,本公司将利用募集资金对士兰集成公司、成都士兰公司进行增资。

2. 募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明

根据公司2018年1月23日公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》,鉴于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额,公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入的金额,具体调整情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	原拟用募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额
年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目	80,253.00	80,000.00	70,559.43
其中:MEMS传感器芯片制造扩产项目	37,900.00	37,647.00	30,568.43
MEMS传感器封装项目	22,362.00	22,362.00	20,000.00
MEMS传感器测试能力提升项目	19,991.00	19,991.00	19,991.00
合 计	80,253.00	80,000.00	70,559.43

(三) 募集资金使用和结余情况

本公司、士兰集成公司及成都士兰公司2019年1-6月份实际使用募集资金589.08 万元、使用募集资金暂时补充流动资金 24,000.00 万元,归还募集资金暂时补充流动资金14,000.00 万元,2019年1-6月份收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为167.87万元;截至2019年6月30日,公司累计已使用募集资金15,797.89 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为281.99万元。

截至2019年6月30日,本公司、士兰集成公司及成都士兰公司募集资金余额为31,140.10万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《杭州士兰微电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并于2018年1月23日与东方花旗证券有限公司及中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。募投项目实施主体士兰集成公司对以增资方式收到的募集资金,也实行了专户存储,本公司和士兰集成公司于2018年2月与东方花旗证券有限公司及中国建设银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。募投项目实施主体成都士兰公司对以增资方式收到的募集资金,也实行了专户存储,本公司和成都士兰公司于2018年2月与东方花旗证券有限公司及交通银行股份有限公司杭州市东新支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司、士兰集成公司、成都士兰公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,本公司有3个募集资金专户和6个通知存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号或开户证实书号码	类型	存储金额
本公司	中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行	19033101040020262	募集资金专户	948.26
本公司	中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行	19033101040020262-1	通知存款	4,000.00
本公司	中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行	19033101040020262-2	通知存款	5,000.00
本公司	中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行	19033101040020262-3	通知存款	5,000.00
本公司	中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行	19033101040020262-4	通知存款	3,000.00
本公司	中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行	19033101040020262-5	通知存款	3,000.00
士兰集成公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33050161672700000826	募集资金专户	6,002.46
成都士兰公司	交通银行股份有限公司杭州东新支行	331060680018800024087	募集资金专户	2,189.38
成都士兰公司	交通银行股份有限公司杭州东新支行	331060680608500008311	通知存款	2,000.00
合 计				31,140.10

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司2018年2月6日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过,同意本公司使用闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。本公司于2019年1月2日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金14,000万元全部足额提前归还至募集资金专户。

经2019年1月7日本公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,同意本公司使用部分闲置募集资金14,000 万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

经2019年4月11日本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,同意本公司使用部分闲置募集资金10,000 万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

(二) 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 本公司不存在募集资金投资项目先法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

杭州士兰微电子股份有限公司

二〇一九年八月二十八日

附件1

募集资金使用情况对照表

2019年半年度

编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			70,559.43	本年度投入募集资金总额					589.08	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额					15,797.89	
变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%)(5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目	否	80,000.00	70,559.43	未作分期承诺	589.08	15,797.89		22.39	2020年1月	2019年1-6月份该项目实现销售收入2,089.83万元,实现销售毛利559.01万元,实现净利润-403.14万元。		否
合 计	-	80,000.00	70,559.43		589.08	15,797.89		-		-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)			无									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之(一)2									
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况			无									
募集资金其他使用情况			无									

证券代码:600460　证券简称:士兰微　编号:临2019-037

杭州士兰微电子股份有限公司关于投资建设士兰集昕二期项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资项目名称:士兰集昕二期项目

● 投资金额:项目总投资15亿元,其中:股东出资8亿元,通过金融机构融资解决约7亿元。

● 本次投资无需提交公司股东大会审议。

一、投资概述

(一)投资的基本情况

1.投资项目名称:士兰集昕二期项目

2.公司子公司杭州士兰集昕微电子有限公司(以下简称"士兰集昕")为公司8吋集成电路芯片生产线(以下简称"8吋线")的运行主体。士兰集昕8吋线于2017年6月底正式投产,产出逐步增加,2018年总计产出芯片29.86万片。目前已有高压集成电路、高压MOS管、低压MOS管、肖特基管、IGBT等多个产品导入量产。8吋线持续上量对公司的整体营收增长起了积极推动作用。为进一步提高芯片产出能力,提升制造工艺水平,士兰集昕拟对8吋线进行技术改造。本项目利用士兰集昕现有的公用设施,在现有生产线的基础上,通过增加生产设备及配套设备设施,形成新增年产43.2万片8英寸芯片制造能力。

2.项目投资:本项目总投资15亿元,建设周期约为五年,分两期进行。其中,一期计划投资6亿元,形成年产18万片8英寸芯片的产能。二期计划投资9亿元,形成年产25.2万片8英寸芯片的产能。

3.资金的来源:本项目的总投资约15亿元,其中股东出资约8亿元,其余资金通过向金融机构融资解决。士兰集昕本次拟新增注册资本702,983,849元,公司和国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称"大基金")本次拟以货币方式共同出资8亿元认购士兰集昕新增的全部注册资本。其中本公司出资3亿元人民币,大基金出资5亿元人民币,具体投资方式见本公告"二、投资方式及投资各方的基本情况"部分。本次增资完成后士兰集昕的注册资本将由1,259,395,563元增加至1,962,379,412元。本次出资溢价部分将计入士兰集昕的资本公积。

(二)公司于2019年8月26日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于投资建设士兰集昕二期项目的议案》,同时董事会批准并授权董事长陈向东先生签订与本次投资有关的协议。

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定,本次对外投资金额未达到公司最近一期经审计后总资产的30%,在股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

(三)本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资方式及投资各方的基本情况

(一)投资方式

1.增资集华投资

大基金出资3亿元人民币,本公司出资3.15亿元人民币,共同增资杭州集华投资有限公司(以下简称"集华投资"),出资方式均为货币。本次增资无溢价。其同增资后集华投资的注册资本将增加至102,500万元人民币。

增资完成后,集华投资的股权结构如下所示:

股东名称	增资完成前的持股比例	增资完成前的出资额(万元)	增资完成后的持股比例	增资完成后的出资额(万元)
杭州士兰微电子股份有限公司	51.22%	21,000	51.22%	52,500
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	48.78%	20,000	48.78%	50,000
合计	100.00%	41,000	100.00%	102,500

2.增资士兰集昕

大基金出资2亿元人民币,增资后的集华投资出资6亿元人民币,共同增资杭州士兰集昕微电子有限公司。本次增资每注册资本1元对应的增资款为1.13800623元,故增资款8亿元认缴注册资本702,983,849元。增资后士兰集昕的注册资本将增加至1,962,379,412元。

其中,大基金以货币出资2亿元,认缴注册资本175,745,962元,本次认缴注册资本占增资后士兰集昕注册资本的8.96%;集华投资以货币出资6亿元,认缴注册资本527,237,887元,本次认缴注册资本占增资后士兰集昕注册资本的26.87%。本次出资溢价部分将计入士兰集昕的资本公积。

增资完成后,士兰集昕的股权结构如下所示:

股东名称	增资完成前的持股比例	增资完成前的出资额(元)	增资完成后的持股比例	增资完成后的出资额(元)
杭州士兰微电子股份有限公司	9.80%	123,454,935	6.29%	123,454,935
杭州士兰集成电路有限公司	5.74%	72,303,290	3.68%	72,303,290
杭州高新科技创业服务有限公司	20.94%	263,637,338	13.44%	263,637,338
杭州集华投资有限公司	31.76%	400,000,000	47.25%	927,237,887
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	31.76%	400,000,000	29.34%	575,745,962
合计	100.00%	1,259,395,563	100.00%	1,962,379,412

(二)投资各方的基本情况

1.国家集成电路产业投资基金股份有限公司

(1)公司名称:国家集成电路产业投资基金股份有限公司

(2)成立时间:2014年9月26日

(3)注册地址:北京市市辖区经济技术开发区景园北街2号52幢7层718 室

(4)注册资本:9,872,000万元

(5)法定代表人:王占甫

(6)公司类型:股份有限公司(非上市)

(7)经营范围:股权投资、投资咨询;项目投资及资产管理;企业管理咨询

(8)股东情况:财政部(25.96%);国开金融有限责任公司(23.07%);中国烟草总公司(14.42%);北京亦庄国际投资发展有限公司(7.21%);中国移动通信集团有限公司(7.21%);其他股东合计22.14%。

2.杭州集华投资有限公司

(1)公司名称:杭州集华投资有限公司

(2)成立时间:2015年12月4日

(3)注册地址:杭州市西湖区黄姑山路4号9号楼1楼

(4)注册资本:41,000万元

(5)法定代表人:陈向东

(6)经营范围:服务:实业投资、投资管理、投资咨询(除证券、期货)

(7)股东情况:本公司持有集华投资51.22%的股权,大基金持有集华投资48.78%的股权。

(8)待本次共同投资事项完成后,集华投资的注册资本将由41,000万元增加至102,500万元。

三、投资标的的基本情况

1.公司名称:杭州士兰集昕微电子有限公司

2.成立时间:2015年11月4日

3.注册地址:浙江省杭州经济技术开发区10号大街(东)308号13幢

4.注册资本:1,259,395,563元

5.法定代表人:陈向东

6.经营范围:制造、销售:8英寸集成电路芯片、分立器件芯片、半导体、功率模块;销售:8英寸集成电路芯片、分立器件芯片、半导体、功率模块相关的原材料,机械设备及零配件、仪器仪表;8英寸集成电路芯片、分立器件芯片、半导体、功率模块的技术开发、技术转让;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。

7.现有股东情况:

序号	股东	认缴注册资本(元)	出资形式	持股比例
1	杭州士兰微电子股份有限公司	123,454,935	货币	9.80%
2	杭州士兰集成电路有限公司	72,303,290	货币	5.74%
3	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	400,000,000	货币	31.76%
4	杭州集华投资有限公司	400,000,000	货币	31.76%
5	杭州高新科技创业服务有限公司	263,637,338	货币	20.94%
合计		1,259,395,563		100%

以上所有股东的出资均已全部如实到位。

8.截至2018年12月31日,士兰集昕经审计的总资产为201,954.16万元,负债为94,256.98万元,净资产为107,697.18万元。2018年营业收入为35,099.74万元,净利润为-13,901.00万元。

截至2019年6月30日,士兰集昕未经审计的总资产为211,862万元,负债为112,270万元,净资产为99,592万元。2019年上半年营业收入为21,923万元,净利润为-8,105万元。

四、投资事项对上市公司的影响

如本次投资事项顺利实施,将有效调整公司的资产结构,为公司8吋集成电路芯片生产线的后续建设提供重要的资金保障,有利于加快公司8吋线的建设和运营,从而进一步提升公司制造工艺水平,增强公司盈利能力,提高综合竞争力。

五、投资的风险分析及对策

1.士兰集昕8吋线二期项目的建设周期约为五年,在逐步达产过程中容易受到市场外部环境变化等因素的影响,可能会对该项目效益的整体发挥产生不利影响。

对策:公司将尽快落实解决项目建设过程中出现的各种问题,尽量提前建成并争取早日达产。同时公司将不断加强内部管理,提升工艺技术水平,持续开发新产品,提高市场占有率,进一步拓展销售渠道,与国内外知名客户建立长期稳定的业务关系。

2.本项目工艺设备投资较大,设备采购价格对项目投资影响较大,多台主要工艺设备需从国外进口,因此汇率的不可预期或大幅变化对本项目实施会造成一定压力。

对策:公司将会对当前经济形势以及汇率变化趋势做理性分析及判断,做好前期设备调研、询价工作,把握时机签约采购。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2019年8月28日

证券代码:002684　证券简称:*ST猛狮　公告编号:2019-098

广东猛狮新能源科技股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST猛狮	股票代码	002684
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈乐伍(董事长代行董事会秘书职责)	陈咏纯	
办公地址	广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场综合商贸楼A1501、A1601号	广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场综合商贸楼A1501、A1601号	
电话	0754-86989573	0754-86989573	
电子信箱	msinfo@dynavoltnet	msinfo@dynavoltnet	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	533,977,366.19	754,827,087.85	-29.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-429,179,765.76	-